

SAL1000 デスクトップ型 ALD 装置



【装置コンセプト】

SAL1000ALD装置は、成膜チャンバーと制御電源部を一体化することにより、小型軽量化を実現したコンパクトな卓上設置可能な研究開発用の装置です。

φ100内±3%(AlO₃)以内です。

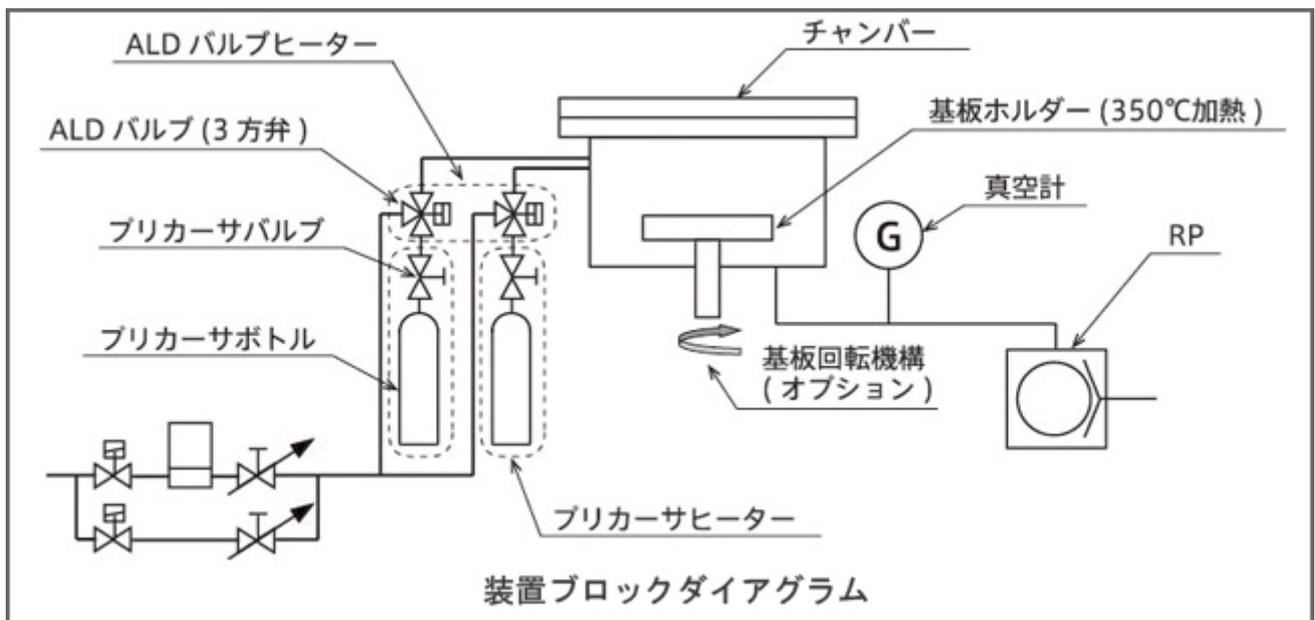
また、装置価格もコンパクト化により、部品点数を抑え700万円以下のお買い求めやすい価格を実現しました。



φ4 基板用(φ100)ホルダー

【特徴】

- ・前面タッチパネルで成膜プロセスを設定でき、圧力や動作状況を確認できます。
- ・真空排気から成膜まで設定したプロセスを自動で実施し、成膜終了後はベントボタンを押せば基板を取り出せます。
- ・プリカーサーは2系統搭載し、対応基板はφ4"までとなります。



[性能及び仕様 (Performance & Component)]

到達圧力 (Vacuum Pressure)	≤5Pa	
膜厚分布 (Uniformity)	φ100mm Area ≤±3%	AlO ₃ にて (In Case of AlO ₃)
成膜方向 (Direction of deposition)	デポダウン (Deposition down)	
基板サイズ (Substrate size)	φ100mmMAX	
基板加熱温度 (Temperature of substrate heater)	350°C MAX	基板ホルダー温度 (Temperature of substrate holder)
プリカーサシリンダー (Precursor cylinder)	2 個 (2 pieces)	加熱温度 150°C Max (Heating Temperature)
ALDバルブ (ALD valve)	パルス開閉 ≥15m sec (Pulse drive)	加熱温度 150°C (Heating Temperature)
N ₂ パージガス機構 (Unit of N ₂ Purge gas)	ニードルバルブ、MFメーター付 (Needle valve with MF meter)	
排気ポンプ (Vacuum Pump)	162 L/min ロータリポンプ (162 L/min Rotary Pump)	

[設置 (Space)]

本体 (Main Part)	重量 (Weight) 50Kg	面積 (Necessity Area) W465 × D600 × H650
ロータリポンプ (Rotary Pump)	重量 (Weight) 27Kg	

[用カ (Utility)]

電力 (Power)	3 φ 200V ± 10% 15A 50/60HZ
接地 (Ground)	D 種接地 (GND for below 100 Ω)
パージガス (Purge gas)	N ₂ 0.1 ~ 0.2 MPa
圧縮空気 (Compressed air)	0.6 ~ 0.8 MPa
ポンプ排気 (Pump exhaust port)	ISO-KF25 フランジ (NW25 Flange)
筐体排気 (Frame exhaust port)	φ38 × L28 ダクトホースアダプター (Hose Adapter)

[オプション (Option)]

基板ホルダー回転機構 (Substrate holder Rolling mechanism)	
プリカーサシリンダー加熱温度 (Precursor cylinder heater)	: 200°C MAX

評価機をご用意しておりますので、サンプルの作成も可能です。
また、特注仕様にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先
東横化学株式会社
事業開発室
Tel : 044-435-5858
<http://www.toyokokagaku.co.jp/>